

证券代码：300410

证券简称：正业科技

广东正业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活 动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	南华基金 衡攀宇 富荣基金 李延峥、毛运宏 凯石基金 陈晓晨、黎磊 开源证券 刘翔 华西证券 王臣复 劳埃德（中国）私募基金管理有限公司 刘黎明 平安银行金融同业事业部 王士涛 上海添佑基金 孙诺 知源投资 杨渡 深圳新华创资产管理有限公司 叶佑林 深圳市榕树投资管理有限公司 李仕鲜、杜志君 深圳市前海天成时代资产管理有限公司 罗辉华 深圳市合心资本管理有限公司 鲁正轩 上海融启财富 余鹏飞 微银资本投资管理有限公司 戚文明 中国葛洲坝集团海外投资有限公司 谢民争 一鸣投资 邓孝军 筑石投资 朱鸿泰 青骊投资(上海)管理有限公司 匡人雷 银叶投资 崔健 海雅金控 林海成

	<p>深圳菁英时代 徐天泽、廖泽略</p> <p>上海禅龙资产管理有限公司 陈鑫</p> <p>万方资产 王安迪</p> <p>深圳市赢合新高资产管理有限公司 罗新高</p> <p>天籁村投资发展有限公司 段子嫣</p>
时间	2021年12月22日
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	<p>董事长/总经理 徐地华</p> <p>董事/副总经理 范斌</p> <p>财务总监 路童歌</p> <p>董事会秘书 王巍</p> <p>锂电事业部总经理 晏俊景</p> <p>半导体事业部技术总监 魏承锋</p> <p>研究院软件研发部负责人 谢尧城</p>
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、介绍正业科技整体情况</p> <p>1、公司简介</p> <p>公司成立于1997年，座落于广东省东莞市松山湖园区，于2014年在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300410。作为国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权示范企业、中国电子电路行业优秀民族品牌企业、广东省制造业企业500强、广东省创新型企业，自成立以来，公司始终坚持“技术立企”的发展理念，以自主创新为主导，以“光学检测和自动化控制技术”为主要技术方向，致力于技术的持续创新，让产品更优质、客户更卓越、生活更美好的企业愿景而奋斗。</p> <p>公司聚焦工业检测领域，向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备相关产品和服务。通过多年持之以恒的努力，公司走出了单机离线检测--自动化在线检测--集成化解决方案--工业检测智能产线的技术、产品发展之路，在20多年的发展历程中，公司的产品不断实现国产替代进口。</p> <p>公司以“光学检测和自动化控制技术”为核心，历经20多年技术研发</p>

沉淀，组建了光、机、电、软、算和料等多学科综合技术创新领域技术团队；截至目前，公司授权发明专利 130 余件，软件著作权 180 余件。基于良好的工业检测技术水平，公司联合中国电子技术标准化研究院参与制定了“智能制造机器视觉在线检测测试方法”的国际标准，并主导或参与制定的检测标准近 30 余项；累计承担或参与国家级重点研发项目 8 项，省市级重点研发项目 30 余项。

2、主营业务情况

(1) 锂电池板块

公司的锂电检测自动化业务处于锂电产业链中游，向锂电池制造厂商提供锂电智能检测设备，对锂电池内部缺陷进行无损检测分析，提高锂电池的安全性和可靠性，能满足新能源汽车及各种电子产品的锂电池检测需求，如卷绕型、铝壳型、圆柱型、叠片型等；产品实现了离线/在线全自动检测，设备前后端可与产线对接，同时提供集成化检测解决方案。

在锂电池产品检测领域，公司根据行业需求定向研发的在线集成化智能检测设备，有助于解决锂电池产品高精度检测难题。

公司在锂电检测细分领域优势突出，技术水平、产销规模、服务能力等方面均具有行业领先优势，获得锂电行业龙头企业的高度认可，与宁德时代、瑞浦能源、珠海冠宇、比亚迪电池、亿纬锂能、孚能科技、长城汽车、维科电池、国轩高科、松下能源等锂电池制造厂商保持稳定合作关系。

(2) PCB 板块

公司的 PCB 智能检测设备广泛应用于 PCB 行业的中游，产品覆盖 PCB/FPC 生产全工艺流程，满足多种检测需求，如线宽、线距、铜厚、板厚、翘曲度、检孔、外观检查、阻抗测试等。设备种类 20 余款，细分型号超过 50 款，涵盖了约三分之一 PCB 制程工序检测和加工需求，产品品质稳定可靠。拥有鹏鼎控股、健鼎科技、美维、深南电路、沪电股份、胜宏科技、景旺电子、兴森科技、明阳电路、博敏电子、崇达技术、奥士康、超声电子等行业知名客户。

(3) 半导体板块

公司在锂电池检测业务的基础上，将 X 光检测技术拓展到半导体行业，针对半导体行业内的分立元件进行在线全自动检测，自主研发的复盘算法能

够实时复盘，边采图边复盘，为半导体行业客户解决检测效率的难题。

截止目前，公司与某全球半导体行业知名厂商已签订了设备采购合同，向该客户提供 8 套搭载了电子光学成像自动识别系统的全自动 X 光检查机，通过“X 光检测技术”自动检测半导体芯片内部缺陷（半导体芯片缺陷类型：有线脱焊，塌陷，跪线，弧度低，断颈，无线脱焊、颈部受损、胶水厚、线尾长、球厚/球大/球畸形等），识别挑选良品与不良品，同时通过复盘功能，确定芯片在料盘中的序号，在后端将不良芯片挑出避免残次品流入半导体芯片成品市场。

（4）平板显示板块

公司的平板显示模组自动化业务处于产业链中游，掌握多项平板显示智能装备核心技术，主要向平板显示制造厂商提供邦定、贴合、背光等中后段模组全自动化生产线。与 BOE、JDI、华星光电、业成、维信诺、夏普、天马、德普特、信利、联创、同兴达、国显、华映等国内外知名厂商建立长期稳定的合作关系。

二、互动交流

1、公司的 PCB 检测设备主要检测哪些指标？

公司的 PCB 智能检测设备主要检测线路板的外观、线路、孔位、层间对位、表面处理等是否合格，检测标准为线路板 IPC 标准。

2、景德镇国资委进场后，能为公司提供哪些资源？

景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）将为公司提供增信、融资等方面的支持；另如公司未来新增产能落地景德镇，合盛投资将为公司在当地争取各项优惠政策，包括厂房免租或租金补贴、土地购置优惠、税收补贴、人才住房补贴、运输补贴、产出效益奖励等。

3、景德镇国资委进场后，对公司信息披露有没有哪些改变？

第一，董事会将不断加强信息披露事务管理，切实提高业务水平，规范信息披露业务审核流程，完善自查机制，强化内部控制监督职能，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。第二，进一步加强内控建设，强化合规意识。对公司信息披露制度进行梳理，查漏补缺。

4、目前公司的在手订单情况以及订单的结构？

公司目前在手订单与公司所属行业景气度较为匹配，其中锂电检测设备

订单占比超过 50%。

5、公司的市场竞争优势？

(1) 产业链整合优势。公司各业务单元的产品和技术的主要下游应用市场是电子信息产业领域，具有良好的协同效应，可通过各种技术整合，软硬兼施提供整体解决方案，从而增强公司的专业服务能力。

(2) 客户协同优势。公司在不同行业领域拥有的稳定客户群体，有利于公司开展业务、开拓市场时，联动作战共同开发客户或对存量客户业务机会的再开发，节省市场开发成本，扩大市场份额，增强客户粘性。

(3) 丰富的客户资源。公司在 PCB、锂电、平板显示等行业，积累丰富优质的客户资源，与国内外等众多知名厂商保持长期稳定的合作关系。

(4) 卓越领先的行业地位

锂电板块：产品多次荣获高工锂电创新产品奖、中国专利优秀奖、国家重点新产品；与众多行业标杆客户保持长期稳定合作关系。

PCB 板块：深耕 24 年，是中国电子电路行业百强企业，产品广泛应用于 PCB 行业的中上游；《2020 年全球 PCB 行业百强企业》中有 98 家是公司的客户。

平板显示板块：公司平板显示业务处于产业链中游，是国内主要的平板显示模组组装设备供应商之一，拥有较高的市场知名度和口碑。

6、公司走的是国产替代进口的路线，公司产品与国外产品相比，具有哪些优势？

国外部分检测设备为单机离线检测，为标准机型（如国外的半导体芯片缺陷 X 光检测设备），设备售价较昂贵、检测效率不高、售后服务耗时长、维护保养成本高。公司可以根据客户技术需求开发定制，价格较国外检测设备具有优势，公司重点面向锂电池、半导体行业的 X 光检测设备为在线全自动产品，检测效率高，对客户的售后维护响应速度快等等。

7、电池检测设备通过 X 光检测电池缺陷是软件算法直接判断还是需要人工判断？

公司的锂电池 X-ray 检测设备，在实现 X-ray 自动测量电池正负极片对齐度，检测电池内部结构缺陷，自动判断良品和不良品，自动分拣不良品的功能基础上，集成了电芯的全自动电压内阻测试、全自动尺寸测量等检测功

	<p>能，还可以配置自动配组分选、电芯 Breaker 激光焊接设备。检测过程无需人工参与。</p> <p>8、公司产品的核心技术？</p> <p>公司产品主要包含微焦点 X 射线成像系统、高速视觉定位系统、恒温恒压控制系统、图像处理系统、运动控制系统、工艺应用、安全防护系统等核心功能模块组成，集成了 X 射线无损检测技术、机器视觉智能检测技术、高速高精度实时控制技术、工艺集成自动化技术、三维重建点云算法、BGA 元器件图像分割算法、动力厚电芯卷绕电芯-单向滤波 tiff 算法、16 位图图像预处理增强算法等，涵盖了光、机、电、软和图像处理等核心技术领域。</p>
附件清单	无
日期	2021 年 12 月 22 日